

厂家生产焊锡膏 无铅环保中温锡膏 中温含银锡膏

产品名称	厂家生产焊锡膏 无铅环保中温锡膏 中温含银锡膏
公司名称	迈尔顺焊锡有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MAX 型号:6351
公司地址	深圳地址：宝安西乡 富强大厦606室
联系电话	0755-61185378 13714785544

产品详情

产品型号：mx-6351

产品说明：

max-6351系列屬於中等活性松香基無鉛低溫免洗錫膏。特別設計以滿足焊後免清洗，且焊後殘留物不會發生分解。max-6351系列不同於其他大多數種類的無鉛免洗焊錫膏，有著很大的可選擇工藝參數範圍，從而使之能適應於不同環境、不同設備及不同應用工藝。max-6351可保證優異的連續性印刷、抗塌能力、表面絕緣阻抗性能。焊後較低的殘留物可以保證ict測試的通過。max-6351有著優異的抗幹能力，在連續印刷條件下仍然能保證12小時焊膏有著良好的粘著力。

特徵 featurus 无鉛焊料 12小時連續印刷能力 6小時塌時間表 無需要氣保護

黏度持續保持不變 16mii (0.4mm) 簡距的可印刷性

焊膏成分 standard paste composition 應用特徵 ipc合金類型 合金粉尺寸 合金粉含量

標準印刷 3 25-45um 89% 細間距印刷 4 20-38um 88.5% 滴注 3 25-45um 85%

物理性能 physical properties 適於89% , -325+500目合金粉焊錫膏 brookfield : 700-1400kcps @ 5 rpm (brookfield viscmter at25) maicom:1700-2300 poise @ 10 rpm(maicom viscometer at25)

錫球測試 合格 測試標準 j-std-005 , ipc-tm-650 , method 2. 4. 43 濕潤性測試 合格 測試標準 j-std-005 , ipc-tm-650 , method 2. 4.45

可靠性能 rel iabilty properties 銅鏡測試 合格 (低) 測試標準 j-std-004 , ipc-tm-650 , method 2. 3.

32. 銅面腐蝕測試 合格 (低) 測試標準 j-std-004 , ipc-tm-650 , method 2. 6. 15 鹵素含量測試

鉻酸銀試紙測試 合格 測試標準 j-std-004 , ipc-tm-650 , method 2. 3. 33 氟點測試 合格 測試標準 j-

std-004,ipc-tm-650, method 2. 3. 35. 1 表面絕緣阻抗 合格 測試標準 j-std-004 , ipc-tm-650 , method 2. 6.

3. 3 ipc tm-650 0小時 >1 × 10012hm 96小時 >1 × 10011hm

操作說明 appl ication notes 用途

max-6351系列適用於sn63/bi35/ag1無鉛焊料合金.推薦採用3號金粉,但根據不同的用塗如標準

印刷和超細間距選用不同的ipc合金末類型。

印刷參數 印刷刮刀 80-90肖氏硬度的聚亞安酯或不銹鋼材料 刮刀速度 25-150mm/sec 磨板材料

不銹鋼、鉬、或黃銅 溫度濕度 溫度70-77f (21-25) 、 濕度35-65% r.h.

回流焊曲线 reflow data

升溫速率 到達150 所需時間 保溫110-140 峰值溫度225 ± 5 >140 >165 冷卻 1-3 /sec

max 90秒 60-100秒 225 30-60秒 10-20秒 <4 /sec

焊後清洗 max-6351系列屬於免洗錫膏。一般應用時無需清洗焊後殘留物。

如需進行清洗，max-6351系列焊後殘留物也很容易借助迈克斯相對應的清洗劑清洗。

包裝形式 瓶裝 --每瓶250克和500克可供選擇

貯存、操作及保存期限 max-6351在5-10 條件下可保存6個月。注意不要對錫膏進行冷凍處理。

錫膏打開包裝使用前需進行充分回溫到室溫（推薦4個小時）

冷藏保存時可能會引起錫膏內組分的分離，使用前充分攪拌錫膏1-5分鐘以充分混合均勻。不要將用剩的錫膏與新的錫膏混合在同一包裝內。錫膏不需要使用時應重新進行密封，當瓶蓋不能很好地進行密封保存時請更換瓶蓋內襯以保證盡可能的密封。

max-6351免洗錫膏合金成份表（sn63/bi35/cu1）成分 sn pb cu cd zn ai sb fe as ag bi

含量 rem 0.03 0.05 0.002 0.002 0.01 0.02 0.02 0.006 1 35 ± 0.5

測試報告型號:max-6351 助焊劑類型：romo 原始資料測試日期：20/09/2013

測試項麼目 依據細則 ipc-tm-650 測試方法 測試要求 測試結果

金屬含量 3.4 2.2.20 89.5-90.5% 89.7% 黏度 3.5 brookfield 700-1400kcps 700-1100

黏度 3.5 maicom 150-250kcps 170-230 3.6 無橋聯 合格

錫球 3.7 2.4.43 無成簇或大錫球 合格 擴展率 4.7.7.2.2 92%

銅鏡測試 3.2.4.1 2.3.32 <50%穿透 合格 鹵素測試 3.2.4.2

鉻酸銀試紙測試 3.2.4.2.1 2.3.33 無顏色改變 合格 氟點測試 3.2.4.2.2 2.3.35.1 無顏色改變 合格

銅面腐蝕 3.2.4.4 2.6.15 輕微腐蝕可接受 合格

表面絕緣阻抗 3.2.4.4 2.6.3.3 0小時 >1.00 × 10⁸ 1.09 × 10¹²

3.2.4.5 96小時 >1.00 × 10⁸ 1.38 × 10¹¹

焊接缺陷及解決方法 元器件移位 可能原因 相對應之解決方法 a)安放的位置不對 校準定位座標

b)焊膏量不夠或定位的壓力不夠 減少焊膏中焊劑的含量 c)焊膏中焊劑含量太高,在再流過程中的焊劑的流動導致元器件移位 加大焊膏量,增加安放元器件的壓力

焊粉不能再流,以粉狀形式殘留在焊盤上 可能原因 相對應之解決方法

a)加熱溫度不合適 改進加熱設備和調整再流焊溫度曲線

b)焊膏變質 注意焊膏冷藏,並將焊膏表面變硬或幹棗部分去掉

c)預熱過度,時間過長或溫度過高 改進預熱條件 焊點錫不足 可能原因 相對應之解決方法

a)錫膏不夠 擴大絲網和漏板孔徑 b)焊盤和元器件焊接性能差 改用焊膏或重新浸漬元氣件

c)再流焊時間段 加長再流焊時間 焊點錫過多 可能原因 相對應之解決方法

a)絲網或漏板孔徑過大 減少絲網和漏板孔徑 b)焊膏粘度小 增加焊膏粘度

元件豎力,出現吊橋現象(墓碑現象) 可能原因 相對應之解決方法 a)定位位置的移位 調整印刷參數

b)焊膏中的焊劑使元氣器件浮起 採用焊劑含量少的焊膏 c)印刷焊膏的厚度不夠 增加印刷厚度

d)加熱速度過快且不均勻 調整再流焊溫度曲線 e)焊盤設計不合理 嚴格按規範進行焊盤設計

f)採用sn63/pb37焊膏 改用含ag或bi的焊膏 焊料球 可能原因 相對應之解決方法

a)加熱速度過快 調整再流焊溫度曲線 b)焊膏吸收了水份 降低環保濕度

c)焊膏被氧化 採用新的焊膏,縮短預熱時間 d)pcb焊盤污染 換pcb或增加焊膏活性

e)元器件安放壓力過大 減少壓力 f)焊膏過多 減少孔徑,降低刮刀壓力 虛焊

可能原因 相對應之解決方法 a) 焊盤和元器件可焊性差 加強對pcb和元器件的篩選

b)印刷參數不正確 減少焊膏粘度,檢查刮刀壓力及速度

c)再流焊溫度和升溫速度不當 調整再流焊溫度曲線 橋接 可能原因 相對應之解決方法

a)焊膏塌落 增加焊膏金屬含量或黏度,換錫膏 b)焊膏太多 減少絲網或漏板孔徑,降低刮刀壓力

c)在焊盤上多次印刷 用其他印刷方法 d)加熱速度過快 調整再流焊溫度曲線 塌落

可能原因 相對應之解決方法 a)焊膏黏度低觸變性差 選擇合適焊膏 b)環境溫度高 控制環境溫度

可洗性差,在清洗後留下白色殘留物 可能原因 相對應之解決方法

a)焊膏中焊劑的可洗性差 採用可洗性良好的焊劑配製的焊膏

b)清洗劑不匹配,清洗溶劑不能滲入細空隙 改進清洗溶劑 c)不正確的清洗方式 改進清洗方法

本公司主营：smt贴片锡膏、6337锡膏、有铅锡膏、无铅环保锡膏、高温sac305无铅锡膏、高温0307无铅锡膏、中温含银无铅锡膏、6351含银无铅锡膏、6353含银无铅锡膏、无铅低温锡膏、低温含铋锡膏、led专用锡膏、smt贴片红胶等等

联系电话：13414785544 qq:305564819